

证券代码： 603459

证券简称：红板科技

江西红板科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券刘博文，国金证券邓小路；中信建投韩宇，前海开源唐栩，嘉实基金彭民；天风电新张童童；招商证券程鑫、鄢凡；中信建投张斯莹，大成基金徐一清；华泰证券郇正林；中信证券团队成员；东吴电子解承堯、闫春旭；摩根士丹利团队成员；德邦基金团体成员。
时间	2026 年 7 月 28 日上午 10:00 2026 年 7 月 28 日下午 15:00 2026 年 7 月 29 日上午 10:00 2026 年 7 月 29 日下午 14:30 2026 年 7 月 29 日下午 16:00 2026 年 7 月 30 日上午 9:00 2026 年 7 月 30 日下午 14:30 2026 年 7 月 31 日上午 9:00（线上） 2026 年 7 月 31 日下午 14:00（线上） 2026 年 7 月 31 日下午 16:00（线上）
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长叶森然 董事会秘书文伟峰
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 1、目前 PCB 行业竞争激烈，公司如何看待当前的行业竞争格局？与同行相比，公司的核心竞争优势体现在哪些方面？ PCB 行业市场空间广阔，应用领域丰富，不同企业在产品结构、技术路线、客户布局等方面各有侧重。公司深耕 PCB 行业多年，在技术研发、产品品质、客户资源、制造能力等方面积累了一定的竞争优势。

	公司始终坚持技术创新驱动发展，持续加大研发投入，不断提升产品技术含量和附加值，优化产品结构，深化与优质客户的合作。行业竞争格局的演变受多重因素影响，包括技术迭代、供需变化、政策环境等，存在一定不确定性。 公司将继续聚焦主业，稳步推进高质量发展，不断提升核心竞争力。具体经营情况请以公司法定披露公告为准，敬请各位投资者理性研判市场，注意投资风险。感谢您的关注！ 2、公司今年研发投入情况如何？主要投向哪些方向？在 IC 载板、mSAP 等高端领域，公司的技术壁垒和良率水平如何？ 公司持续重视研发创新，围绕主营业务及战略发展方向稳步推进研发投入，重点聚焦高阶 HDI、IC 载板、高速高频、先进封装等技术领域，不断提升公司的技术实力和产品竞争力。 公司在 mSAP 工艺、IC 载板等领域具备一定的技术积累，良率水平稳步提升。技术研发及产品良率提升受多重因素影响，包括技术难度、工艺成熟度、设备条件等，存在一定不确定性。公司将持续加大研发力度，推进技术成果转化。具体研发投入及成果请以公司公告及定期报告披露内容为准，敬请各位投资者理性研判市场，注意投资风险。感谢您的关注！ 3、公司 7 月 24 日公告披露的扩产项目，主要投向哪些产品品类？对应下游应用场景是什么？未来产能消化如何保障？ 本次投资扩产项目，主要围绕公司高端 PCB 核心主业布局，重点投向算力基础设施、高速光通信、高端消费电子、汽车电子等领域所需的高阶印制电路板产品，贴合 AI 产业、数据中心、新能源汽车等下游长期发展趋势。 产能消化依托现有长期合作优质客户基础、持续拓展的头部客户资源以及行业中长期需求增量，但订单落地、客户认证、需求释放受多重外部因素影响存在不确定性。项目具体投资额度、建设周期、产能规模等详细内容均已在公告中披露。后续建设推进等具体情况请以公司公告及定期报告披露内容为准，敬请各位
--	---

	投资者理性研判市场，注意投资风险。感谢您的关注！ 4、公司判断高端 PCB 需求持续性的逻辑是什么？如何应对行业产能扩张带来的竞争加剧风险？ 公司基于 AI 算力建设、高速光模块迭代、新能源汽车电子化、高端智能终端升级等产业趋势，判断高端 PCB 需求具备中长期支撑。 面对行业竞争，公司依靠先进工艺、稳定良率、客户资源、规模化制造等方面的优势积极应对，同时持续加大研发投入，提升产品附加值。行业需求兑现速度、同业产能投放节奏受多重因素影响，存在不确定性，公司将根据市场变化灵活调整项目实施节奏。具体经营情况请以公司公告及定期报告披露内容为准，敬请各位投资者理性研判市场，注意投资风险。感谢您的关注！ 5、公司此次同时推进 mSAP 新建和 HDI 技改两个项目，请问两者在产品定位和下游应用上有何区别？是否存在内部竞争？两个项目之间有何协同效应？ 公司高精密 HDI 产线技改与产能扩充项目，主要是对现有成熟 HDI 产线进行技术升级和产能优化，进一步提升高阶 HDI 产品的制造能力与良品率，巩固公司在 HDI 领域的竞争优势。高阶 mSAP 产业化项目则是面向更高精密度的先进封装、高端消费电子等新兴应用领域的战略布局，属于公司产品结构的延伸与升级。两个项目分别对应不同的技术路线与市场层级，不存在内部竞争关系，而是形成梯次互补的产品矩阵，有助于公司把握不同细分市场的发展机遇。项目的具体实施进度及效益情况请以公司公告及定期报告披露内容为准，敬请各位投资者理性研判市场，注意投资风险。感谢您的关注！
--	--